

アドバンスドパッケージ向けの革新的レーザースクライビング装置を SEMICON Japan 2025にて国内初公開

**独自のレーザーと高精度ステージにより業界最速クラスにして
最も汎用性の高いスクライビング・ダイシングを提供します。**

当社の米国関連会社のナノヴァーステクノロジーズ（Nanoverse Technologies, Ltd. (NVT)、本社 ビーバートン、オレゴン州、米国、代表取締役ジェフリー・アルベロ）は、2025年12月17日～19日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」で、当社ブース(サウス1st floorホール、S1723)にて、アドバンスドパッケージ向けの革新的レーザースクライビング製品を日本で初めて発表します。今回の発表は、ナノヴァーステクノロジーズのアドバンスドパッケージ向け製品ファミリーの中の主力製品 NVT 7700です。

NVT 7700：
レーザーシンギュレーションと計測の完全統合装置

【製品特徴】

- ・独自のレーザーによる理想的レーザースクラバーとダイシング
- ・業界トップクラスのスループットと再現性
- ・マルチシャトルチップに対応
- ・Chip(die)強度が業界トップクラス他社比較3倍
- ・業界初3Dリアルタイム計測機能を装備



NVT 7700

レーザーシステムはナノヴァーステクノロジーズ独自のカスタマイズされたレーザーで、NVT 7700は、レーザースクライビング・ダイシング機能と計測ソリューションを統合した業界唯一のツールです。

ナノヴァーステクノロジーズは顧客へのエハのサンプル提供を積極的におこなっており、ティア1半導体工場にツールを導入しています。2026年に予定されている量産導入に先立ち、製造およびサポート能力の拡大を進めています。2025年12月17日～19日に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2025」で、当社ブース(South 1stホール、S1723)にて、発表・展示をします。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ナノヴァーステクノロジー (Nanoverse Technologies, Ltd.)
HP : <https://www.nanovtech.com/>

【ナノヴァーステクノロジーお問合せ先】

日本：
高村 淳
電話：+81-90-4011-9921
メール：jun.takamura@nanovtech.com

グローバル：
Jeffry Albelo
Email : jeff.albelo@nanovtech.com